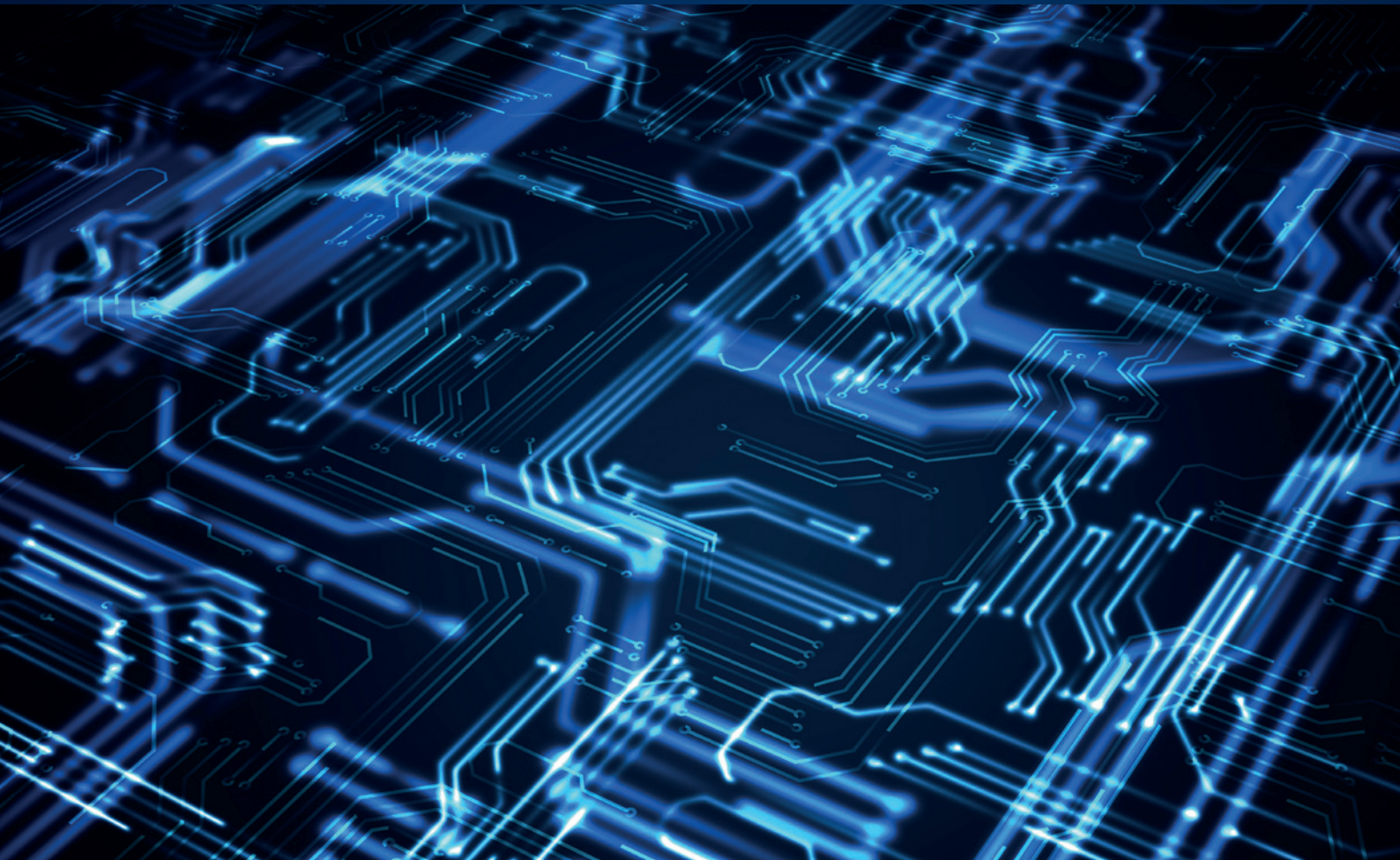


HiPIMS联手金刚石， 成就 PCB 加工卓越性能



可靠且经济的涂层技术：

助力 人工智能、5G 手机、电动汽车制造等领域。

采用高品质、高稳定性的CemeCon涂层，保障 PCB 加工刀具的效率、质量与耐用性。

HiPIMS涂层技术

- ✓ 极其光滑,无液滴
- ✓ 加工速度遥遥领先
- ✓ 确保 PCB 板最佳加工效果
- ✓ 涂层绝对均匀一致
- ✓ 整批产品涂层质量稳定

HiPIMS能够以几乎无限的种类,沉积出光滑、无液滴且残余应力低的涂层。

其致密且近乎非晶态的结构,赋予涂层兼具高硬度与强韧性的双重属性。在诸如PCB加工刀具切削刃这样的三维物体上,涂层厚度及其分布完全一致且均匀,能有效延长 PCB 钻头、铣刀等小型刀具的使用寿命。

在应用层面,HiPIMS的沉积速率高达 $2\mu\text{m/h}$,意味着最大的灵活性和最高的生产效率。



金刚石涂层技术

- ✓ 硬度顶尖
- ✓ 适配含陶瓷填料、玻璃层的下一代 PCB 板加工
- ✓ 市场容量最大
- ✓ 超耐磨
- ✓ 高导热

CemeCon是金刚石涂层领域的先驱,25年来持续为客户提供这项技术带来的竞争优势。

CC800® Diamond 是一款紧凑型全自动金刚石涂层系统,外形尺寸小巧,拥有市场上最大的容量。该系统配备三个独立运行的涂层腔室,使其同时具备高灵活性和高经济性。



最佳涂层， 最佳加工效果



在CemeCon的涂层材料系列中，当您为PCB加工刀具选择涂层时，我们建议您详细了解以下两种产品：

HiPIMS MultiCon®

MultiCon® 是一种基于AlCrN的HiPIMS涂层，因其光滑的涂层表面和完全无液滴的特性，显著提升钻头和铣刀的刀具性能。

cemecon.com/multicon

材料: EM-390

刀具: PCB 钻头- Ø 0.25 mm



CCDia® 系列

CemeCon的CCDia® 系列金刚石涂层是加工含有陶瓷填料或玻璃层的高端印刷电路板的关键。CemeCon全球领先的金刚石涂层技术，为PCB行业树立了黄金标准。



- ✓ 高硬耐磨：降低加工磨损，延长刀具寿命。
- ✓ 耐热性优：高温、高速下，加工性能稳定。
- ✓ 摩擦系数低：减少材料粘附，提升加工精度

获取相关信息



cemecon.com/contact

编辑: CemeCon AG / Adenauerstr. 20 A4 / 52146 亚琛 / 德国

CemeCon Inc., 美国 - CemeCon K.K., 日本 - CemeCon 苏州, 中国 - CemeCon Pvt. Ltd., 印度